

設計技術シリーズ
『電子機器の小型化・高性能化のための部品内蔵基板設計』
の訂正とお詫び

本書『電子機器の小型化・高性能化のための部品内蔵基板設計』の記述に誤りがございました。

謹んでお詫び申し上げますとともに、以下のように訂正申し上げます。

科学情報出版（株）

◇ P. IV

誤

4. 2 （執筆担当：遠藤 敬一）

正

4. 2 （執筆担当：遠藤 敏一）

◇ P.244 10. 2. 1 三次元半導体研究センター

・ 2 行目

誤

2021 年 3 月設立

正

2011 年 3 月設立

・ 8 行目

誤

国際特許 (IEC/TC91)

正

国際規格 (IEC/TC91)